

CMP・ポリッシングスラリー



最適なスラリーをお選びいただくために

ニッタ・ハース株式会社製品をはじめとした高品質な各種スラリーを取り揃えております。

| シリーズ | Machplaner™ | | | | | Nanopure™ | | | | | ILD™ | ACuPLANE™ | Novaplane™ |
|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|----------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | MS2020 | MS2100 | MS3000 | MS4100 | ST2010 | NP6504 NP6610 | NP7310 | NP8030 NP8100 | EG1103 | NP1000MS | ILD3013 ILD3225 | ACuPLANE LK393c4 | Novaplane™ 1000 |
| シリコン | 1次研磨 | | | | | ● | | | | | | | |
| | 2次研磨 | | | | | | ● | | | | | | |
| | Final研磨 | | | | | | | ● | | | | | |
| | エッジ研磨 | | | | | | | | ● | | | | |
| 半導体 CMP | 酸化膜 | | | | | | | | | | ● | | |
| | Cu | | | | | | | | | ● | ● | | |
| | W | | | | | | | | | | | ● | |
| | Poly-Si | | | | | ● | | | | | | | |
| サファイア | C面仕上げ研磨 | ● | | | | | | | | | | | |
| | A/R面仕上げ研磨 | | ● | | | | | | | | | | |
| 各種基板 | SiC/GaN | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | LT/LN | | ● | ● | | | | | | | | | |
| | 酸化物 | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | 水晶 | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | 石英/ガラス | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | レジン/プラスチック | | ● | | | | | | | | ● | | |
| | ステンレス | | ● | | | | | | | | | | |
| | セラミックス | | ● | | | | | | | | | | |
| | パッケージ基板用Cu | | | | | | | | | ● | | | |

※その他、本カタログ掲載以外の各種スラリーを数多く取り揃えていますので、お気軽にご相談ください。

各種基板向け 研磨スラリー

Machplaner™シリーズ

Machplaner™シリーズはさまざまな基板に効果的な万能スラリーです。各種難研磨物への高研磨レート等お客様のニーズを満たすラインナップを取り揃えています。



概要

- 高品質な表面が要求されるガラス・サファイア基板をはじめ幅広い種類の基板研磨に対応
- 表面粗さ低減と高研磨レートの両立
- 希釈可能で循環使用時も、高性能かつロングライフを実現

| | MS2020 | MS2100 | MS3000(A液物性値) | ST2010 | MS4100 |
|-----------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|
| 主成分 | コロイダルシリカ | | | | アルミナ |
| 砥粒濃度(wt%) | 38.0 | 50.0 | 50.0 | 22.0 | |
| pH | 9.0-9.5 | 8.2-9.2 | 3.0-5.0 | 10.5-11.5 | 13.5 |
| 砥粒サイズ(nm) | 60-120 | 100-160 | 80-120 | 110-170 | 180-220 |
| 研磨対象物 | サファイアC面 難研磨物全般 | サファイアA面 難研磨物全般 | タンタル酸リチウム(LT) ニオブ酸リチウム(LN) | ガラス | 樹脂 |
| 比重 | 1.10-1.40 | 1.36-1.40 | 1.36-1.4 | 1.08-1.20 | 1.00-1.10 |
| 標準希釈倍率 | 2倍希釈タイプ | 3倍希釈タイプ | 2.5倍希釈タイプ | 原液使用タイプ | 原液使用タイプ |
| 特長 | 摩擦抵抗低減 パッド表面温度が 上がりにくい | 洗浄性に優れる 高圧研磨に最適 | 2液混合タイプ 高研磨レート | 表面粗さ低減 原液使用 | 高研磨レート 他材料との高選択性 |

※その他、本カタログ掲載以外の各種スラリーを数多く取り揃えていますので、お気軽にご相談ください。

梱包形態

内袋式のHBIB容器に24kg充填してお届けします。ドラム、コンテナ、少量容器のご用意もございます。
※ST2010 は、20kg入りでお届けいたします。



CMP・ポリッシング
スラリー